



Ampoc Far East Co., Ltd.

揚博科技股份有限公司  
Ampoc Far-East Co., Ltd.

股票代號：2493



2019/09/09



- 一、公司簡介
- 二、公司沿革
- 三、產業應用與產品介紹
- 四、財務資訊
- 五、未來展望





# 一、公司簡介

公司名稱	揚博科技股份有限公司
地址	台北市松德路171號17樓
電話	(02)2726-2220
董事長	蘇勝義 先生
總經理	喬鴻培 先生
資本額	新台幣 114,437 萬元
設立日期	1980年11月1日
員工人數	280人
公司網站	<a href="http://www.ampoc.com.tw">www.ampoc.com.tw</a>



蘇勝義先生



## 二、公司沿革

### AMPOC's History



2006/12

• 吸收合併百分之百持有之揚鑫投資股份有限公司，合併後資本額不變

2002/01

• 經證管會核准於 2002/1/23 股票掛牌上市，代號 2493。

2001/06

• 申請公司名稱變更為「揚博科技股份有限公司」，盈餘轉增資，股本增加為 90,500 萬元。

2000/10

• 辦理現金增資 4,800 萬元、盈餘轉增資 3,997 萬元、合併資本公積轉增資 7,424 萬元、員工紅利轉增資 401 萬元，增資後資本額為新台幣 73,729 萬元。

1999/12

• 合併台北化工機械股份有限公司，並增資發行新股 21,107 仟股，股本增為 57,107 萬元。

1998/12

• 獲准成為公開發行公司，辦理盈餘轉增資 10,200 萬元，增資後資本額為新台幣 30,000 萬元。

1998/03

• 設立精密儀器檢測服務實驗室，加強對客戶服務內容與品質。

1997/03

• 購置並遷入台北市松德路 171 號 17 樓之新辦公室。

1987/05

• 日本 TCM 於中壢工業區設立台北化工機械股份有限公司，產製 PCB 濕製程設備，本公司除參與投資外並取得日本以外全球獨家銷售權。

1980/11

• 揚博企業股份有限公司成立，股本 100 萬元。



## 三、產業應用與產品介紹

### □ 產業應用

- 半導體前段
- 先進封裝製程
- MEMS

### □ 產品介紹

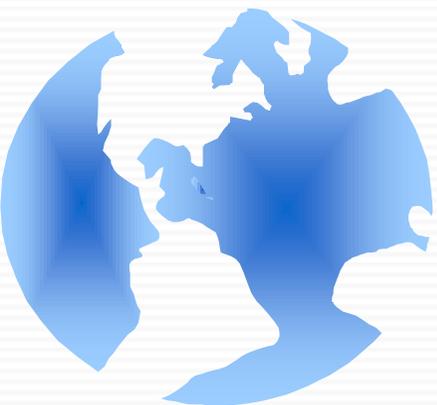
- 垂直Ampoc Wing Etching系統
- 傳統水平式設備
- Laser Heater TC Bonder



Ampoc Far East Co., Ltd.



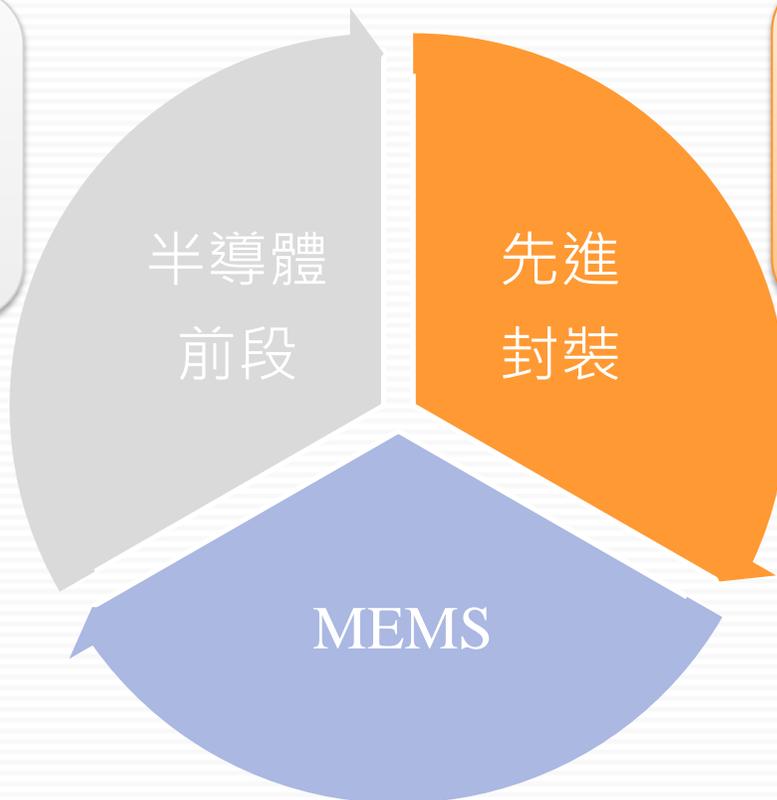
## 產業應用





# 產業應用-核心發展策略

- ✓ 覆晶晶圓凸塊封裝電鍍液。
- ✓ 3D-IC · FOWLP 高速電鍍藥水。
- ✓ 晶圓凸塊UBM層高選擇性蝕刻液。
- ✓ 高解析光阻液。
- ✓ Hard Mask



- ✓ 導線架 metal finish 用藥水。
- ✓ QFN導線架 電著光阻
- ✓ 高階fine pitch探針卡用MLO



# 主要客戶群與合作夥伴





Ampoc Far East Co., Ltd.

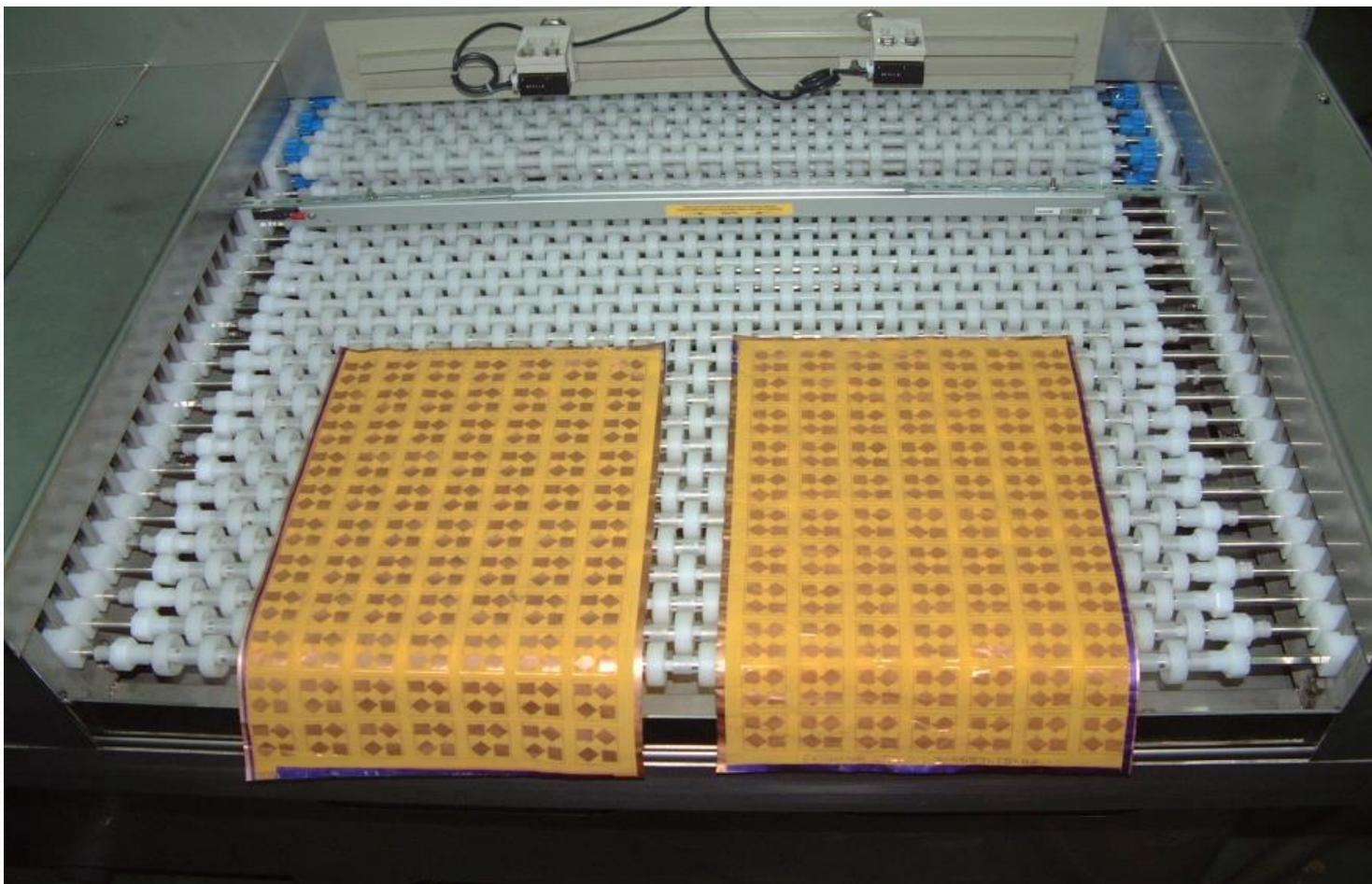


# 產品介紹





傳統水平式設備：板面接觸滾輪造成刮傷與汙染問題





Ampoc Far East Co., Ltd.

# ABF載板垂直顯影系統 (Ampoc Wing)



揚博科技股份有限公司

*Ampoc Far-East Co., Ltd*

ABF載板製程用

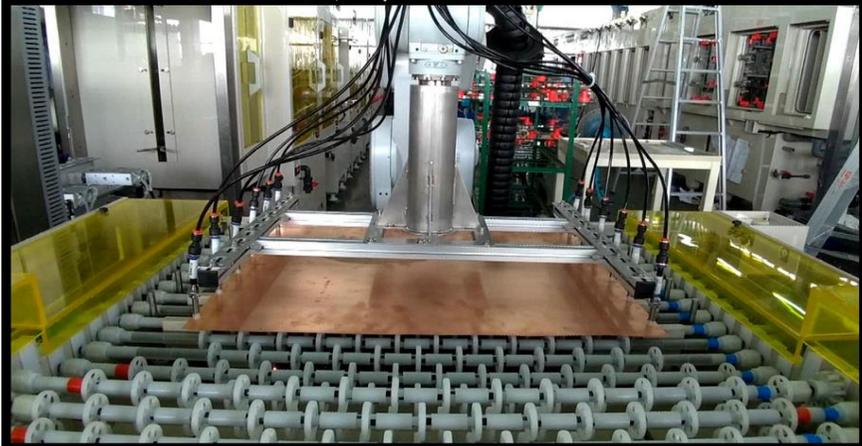
AMPOC WING垂直顯影線





# ABF載板垂直顯影系統 (Ampoc Wing)

自動上料系統



ABF 電路板載入顯影機進行藥液處理



自動換夾系統



ABF 電路板進行第2次藥液處理



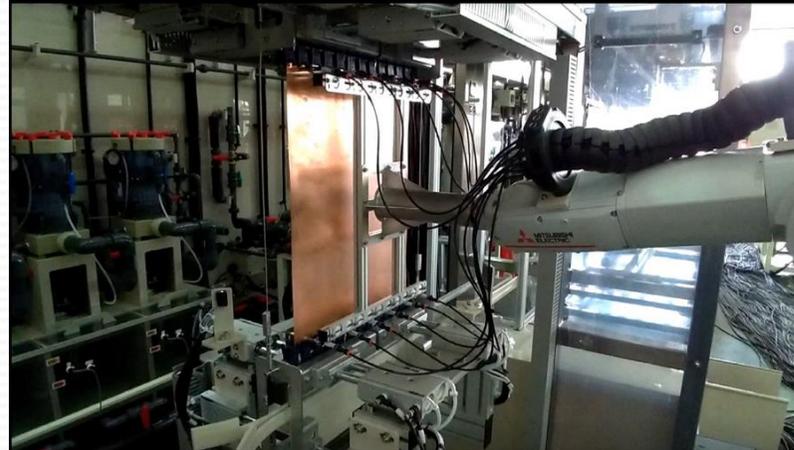


# ABF載板垂直顯影系統 (Ampoc Wing)

電路板進行U型自動迴轉



ABF電路板處理完成自動下料系統

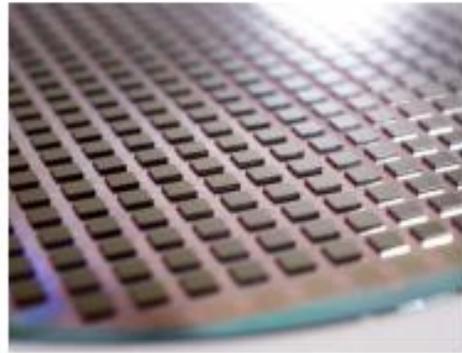


複合尺寸自動換框生產系統





# Laser Heater TC Bonder



- Fast heating and cooling
- Low thermal expansion
- Localized heating





## 2019年市場狀況與未來展望

2019上半年整個半導體產業與封裝產業因需求日益疲軟，除了智慧型手機需求下修，汽車與工業的需求減少、虛擬貨幣價格大跌，又因中美貿易的干擾下，使得整體半導體產業需求不振，上半年度半導體市場持續消耗庫存；在外界看來，電子業受到非常大的衝擊，但另一角度更是揚博在代理業務可積極拓展非美系產品的新契機，因中美貿易之延伸效應，下半年度計畫往中國大陸市場持續邁進。

台灣在多年的電子業經驗下，保有硬體上的優勢及完整的上下游供應鏈，揚博代理部份秉持著多年於電子業界的經營理念，仍以審慎的態度持續耕耘，進而積極佈局半導體前段、先進封裝、智能感測元件(MEMS)此三大方向。



## 台灣PCB產業2018年回顧及2019年展望

- 2018年全球電路板產值達到美金691億，達到歷史新高水準。
- 2018年主要PCB生產國市佔率前3名分別為：
  - 台灣:31.3% **▬** (31.3%)
  - 中國:23.0% **↑** (17.4 %)
  - 日本:19.1% **↓** (20.5%)

2018年雖然台灣仍以31.3%的全球市場占有率奪冠，但中國大陸的占比也達到了23%，且市占率和成長率急速上升中，陸資廠商仍不畏威脅積極擴產且更積極募資投資高密度、高層數產品，另外他們還透過頻繁併購，來擴大產能及增加業務範圍。

- 2018年IC載板、汽車電子與智慧手錶、藍芽耳機仍扮演PCB產業主要成長動能。
- 2019年下半年預估PCB擴充產能其產品包含ABF載板、軟板、軟硬接合板、應用市場包含智慧型手機、汽車電子、物聯網、網通等產品市場。
- 2019年設備需求觀察重點：
  - 一、ABF載板高階製程設備需求。
  - 二、陸資廠商跨入高階產品競爭，包括HDI、軟板、類載板、5G載板設備需求。
  - 三、汽車電子廣泛運用後對相關設備需求。



## 四、財務資訊

### 最近年度綜合損益表

單位：新台幣仟元

項目	年度	106年	107年	108年上半年
營業收入		2,281,684	2,400,520	1,241,236
營業毛利		677,644	765,833	332,522
毛利率(%)		29.70	31.90	26.79
營業利益		310,926	423,299	175,076
稅後淨利		247,036	342,985	135,911
每股盈餘(元)		2.16	3.00	1.19



## 最近年度資產負債表

單位：新台幣仟元

項目	年度	106年	107年	108年上半年
流動資產		2,493,281	2,713,049	2,849,193
非流動資產		752,903	758,096	748,407
資產總額		3,246,184	3,471,145	3,597,600
流動負債		860,792	938,712	1,207,320
非流動負債		130,608	108,930	117,786
負債總額		991,400	1,047,462	1,325,106



## 最近年度財務分析

項目	年度	106年	107年	108年上半年
負債佔資產(%)		30.54	30.18	36.83
流動比率(%)		289.65	289.02	235.99
存貨周轉率(次)		2.09	1.89	2.22
權益報酬率(%)		11.02	14.66	5.79



## 五、未來展望

(一)業務發展方向

(二)競爭優勢

(三)發展不利因素及對策





## (一) 業務發展方向

➤ 研發創新技術因應未來趨勢之利基設備：

1. HDI及類載板製程設備

2. 軟板及厚板製程設備

3. 車載板製程設備

4. 智慧化設備

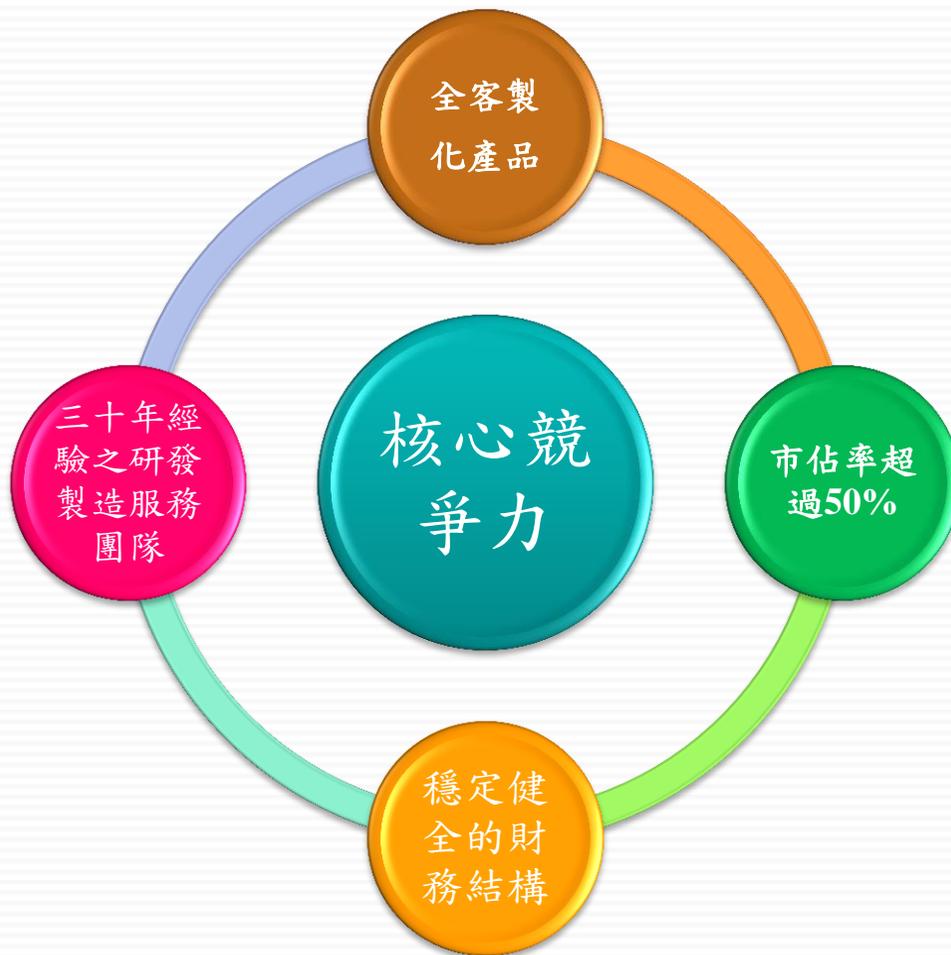
➤ 開發未來新市場客戶：

1. 東南亞

2. 印度



## (二) 競爭優勢





## (三)發展不利因素及因應對策

### ➤同業低價競爭

投入大量的研發人力及經費，持續研發各項創新技術之設備，爭取製造高階產品客戶的製程設備之利基型訂單。

### ➤人力及材料成本提高

透過基礎實驗參數設計新型結構及開發適用新材料，降低高價材料使用。



Ampoc Far East Co., Ltd.



*Thank you*  
*The End*

